

## 2025 电子封装技术国际会议

2025年8月5-7日 中国·上海

## 2025 电子封装技术国际会议 (ICEPT 2025)

2025 年 8 月 5-7 日，中国-上海市

## 会议通知

2025 电子封装技术国际会议(ICEPT 2025)将于 2025 年 8 月 5 日至 7 日在中国上海举行。会议由中国科学院微电子研究所、上海大学、国际电气电子工程师协会电子封装学会(IEEE-EPS)和中国电子学会电子制造与封装技术分会(CIE-EMPT)主办，上海大学微电子学院(上海微电子产业学院)、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、北京恒仁致信咨询有限公司承办。ICEPT 会议是国际最著名的电子封装技术会议之一，会议得到了 IEEE-EPS 的大力支持和中国电子学会、中国科协的高度评价，已成为国际电子封装领域四大品牌会议之一。后摩尔时代背景下，半导体制造技术面临挑战，新技术不断涌现，先进封装在产业链中的地位愈加重要。本会议将为来自海内外学术界和工业界的专家、学者和研究人员提供电子封装与制造技术新进展、新思路的学术交流平台。

在为期三天的会议中，来自多个国家和地区的参会者将通过主题报告、专题讲座、特邀报告、论文张贴 (Poster)、展览展示、分会报告等形式，交流电子封装技术的最新技术发展。我们诚挚地邀请您参加此次会议！

## 一、大会主要信息

## 专题讲座：

1. 听课注册：2025 年 8 月 4 日
2. 讲座日期：2025 年 8 月 5 日

## 大会：

1. 现场注册：2025 年 8 月 5 日
2. 会议时间：2025 年 8 月 6-7 日

会议地点：中国·上海 上海嘉定区喜来登大酒店（上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路 66 号）

会议官方网站：www.icept.org Email: icept@fsemi.tech

投稿链接：<https://easychair.org/conferences/?conf=icept2025>

## 摘要及论文提交：

2025 年 3 月 20 日，摘要投稿截止日期；2025 年 4 月 20 日，摘要接收通知日期；

2025 年 5 月 20 日，全文投稿截止日期；2025 年 6 月 30 日，全文接收通知日期。

会议规模：500 人左右



## 二、会议专题

- **先进封装:** 2.5/3D 封装, 芯粒 (Chiplet) 集成, 晶圆级/板级扇出与扇入型封装, 倒装芯片封装, 系统级集成, 其他异质异构集成封装技术。
- **封装材料与工艺:** 封装材料, 高端封装基板技术, 绿色/纳米封装材料, 其他封装/组装工艺相关的封装材料。
- **封装设计与建模:** 复杂封装的设计、建模、算法与仿真技术, 跨尺度与多物理场的特性建模、算法与仿真技术, 工艺仿真技术等。
- **互连技术:** 硅通孔 (TSV), 玻璃通孔 (TGV), 凸点和微铜柱技术, 高密度互连技术, 混合键合技术, 纳米材料键合技术, 芯片-晶圆/面板和晶圆-晶圆互连技术, 热压焊技术, 其他新型互连技术等。
- **先进制造:** 先进封装工艺牵引下的制造、组装、测试等封测设备, 新原理封测设备, 设备主要或关键零部件、模组技术。
- **质量与可靠性:** 封装测试技术, 新型可靠性实验技术, 可靠性评估方法, 可靠性数据采集和分析方法, 可靠性仿真, 寿命预测, 失效分析和无损检测。
- **功率电子与能源电子:** 功率电子封装相关互连、热管理和基板技术, 宽禁带半导体封装技术, 超宽禁带半导体封装技术, IGBT、SiC、GaN 混合封装技术, 高电压封装技术, 高结温封装技术, 多功能集成封装技术, 其他功率半导体封装技术, 开关、隔离/非隔离电源、逆变器、IPM、POL、PSiP 等功率模组的封装与集成方法, 功率模组控制算法, EMI 建模与优化, 工业模组和车规模组及系统, 其他新能源及新型功率电子模组。
- **光电子与显示技术:** 光显示、光通信、光传感、激光器等封装内光电集成的设计、仿真、互连、封装技术。
- **微机电封装、传感器与物联网:** 微/纳机电系统 (MEMS/NEMS) 封装, 传感器封装, 植入式器件封装, 微流体 3D 打印封装, 自对准和组装技术, 微机电和传感器的晶圆级/板级封装等。
- **射频电子封装:** 射频集成电路与封装交互设计、射频封装与模组设计、射频异质集成工艺、射频无源器件与集成、射频器件与系统散热、射频封装可靠性、毫米波/THz 前沿技术、封装天线一体化、封装射频噪声抑制、声表/体声波谐振器、滤波器相关技术等。
- **新兴领域封装:** 适用大算力芯片的带宽提升与规模提升的封装技术, 大算力芯片的集成电源技术、大算力芯片的高效散热技术、人工智能在封装设计、制造、测试领域的应用, 射频一体化模组技术、可穿戴/柔性和生物电子封装等。

## 三、展位征集

ICEPT 2025 期间将会同时举办电子封装技术国际展, 为封装测试技术产品、科研仪器与设备、材料、组件、软件供应商、制造商及服务商等企业提供市场推广平台。并且, 展区还将设立高端人才交流展区。有意向预定展位的厂商请联系 [janey@fsemi.tech](mailto:janey@fsemi.tech) 与有关人员洽询。

会议财务(含收入和支出)事宜均由北京恒仁致信咨询有限公司负责。

#### 四、大会秘书组、会务组联系方式

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 上海大学      | 嵇啸啸：电话：18621199790 Email: icept@fsemi.tech         |
| 中科院微电子研究所 | 尹 雯：电话：010-82995675                                |
| 会议注册联系人   | 王晓楠：电话：13121110782 Email: support@fsemi.tech       |
| 会议赞助联系人   | 施玥如：电话：13661508648 Email: janey@fsemi.tech         |
|           | 周娟娟：电话：13683163150 Email: juanjuan.zhou@fsemi.tech |

